

2023第25届深圳国际半导体展览会

产品名称	2023第25届深圳国际半导体展览会
公司名称	广州市华亚展览服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市天河区珠村东环路66号
联系电话	18620712559

产品详情

2023第25届深圳国际半导体展览会

时间：2023年11月15-19日（五天）

地点：深圳福田会展中心

碳中和、芯发展

基本信息

展览时间：2023年11月15-19日

展览地点：深圳福田会展中心

主题：碳中和、芯发展

影响全球：全球30多个和地区千家行业合作媒体全面推广、全程报道，尊享品会展的影响力

同期活动：同期召开多场技术研讨会及活动吸引用户及本行业人士莅临交流

组织单位：深圳励宸国际展览有限公司

深圳市亚威会展有限公司

合作媒体：中国电子商情、电子技术应用、21ic电子网、IC交易网、Techsugar、半导体世界、半导体网城、半导体芯科技、存储在线、单片机与嵌入式系统、电子产品世界、电子发烧友、电子工程世界、集邦咨询、集微网、猎芯网、摩尔精英、我爱方案网、芯片揭秘、芯师爷、芯思想、与非网、中电港等

展会介绍

中国半导体产业将顺势而为，逆势崛起

随着人工智能、智能汽车、无人机、汽车电子、安防、物联网、手机、消费及穿戴电子、家电、电源、5G通信等新技术的快速发展，推动了对于半导体需求的持续快速增长，为全球半导体行业增添了新的动力。作为全球电子制造业的中心以及全球大的消费电子市场，近年来中国半导体产业也是增长迅速，中国已经成为全球大和贸易活跃的半导体市场。再加上中国政府对于半导体行业的大力扶持，中国半导体行业发展呈加速态势。“十四五”期间，我国半导体产业将有更全面的发展，并将加快高端芯片设计等领域关键核心技术的突破和应用。随着中国对5G、AI、IoT和云计算、大数据等技术的大量投资，以5G网络、工业互/物联网等为代表的“新基建”将带动半导体产业的高速增长。据预测，到2030年我国的半导体市场供应将达到5385亿美元，依然为全球大，69%的消费量将来自中国本土公司，需求主要来自数据中心、消费电子、汽车、医疗等应用领域。

作为中国科技创新中心，深圳是我国半导体产品的集散中心、应用中心和设计中心，深圳的半导体产业多年来一直保持高速增长态势，特别是IC设计产业一直位于全国前列。近年来，国内对半导体产业重视力度空前，深圳正作为广东省主阵地打造全国半导体产业第三极，不断加大对半导体产业的政策与资金支持力度。2022年6月，深圳出台“20+8”产业政策，发布了《深圳市培育发展半导体与集成电路产业集群行动计划(2022-2025年)》，提出加快完善集成电路设计、制造、封测等产业链条，推动开展EDA工具软件、半导体材料、高端芯片和先进制造等相关重点工程，推进12英寸芯片生产线、第三代半导体等重点项目建设，高水平打造一批半导体与集成电路产业基地和产业园区。随着政策的发布与实施，在国内5G通信、新能源汽车、工业互联网、大数据、光伏等行业快速发展的大趋势下，以及“碳达峰、碳中和”绿色低碳战略不断推进，第三代半导体市场应用已逐步开启，产业规模不断壮大。

作为华南地区乃至全国的**性、专业化半导体行业品牌盛会，2023第25届深圳国际半导体展览会将于2023年11月15日-19日在深圳福田会展中心举办，本届展会专注于整合半导体行业创新产品、技术、解决方案及商业合作模式的发掘，为半导体企业品牌推广、产品展示、交流合作提供一站式解决方案平台，助力企业实现全产业链的交流和互通。作为兼具规模和影响力的半导体行业品牌盛会，展会遵循市场发展趋势，给国内外半导体行业创造提升品牌度和开拓市场的一个契机。充分发挥其传递市场信息与交流先进技术的窗口作用，把脉行业发展方向。共享国际化大平台，共拓半导体大市场，让我们携手同行，共创商机！

展会亮点

科技协同创新：发挥粤港澳大湾区城市群效应，为产业链打造创新升级环境，实现从“世界工厂”向“广东创造”转变，建设成新一代半导体产业集群；实现科技与产业经济与地域经济的相促进。

发掘产业趋势，共铸市场先机：把握半导体产业协同创新要求高、产值体量大、涉及范围广等特点，积极贯彻落实“逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，促进中国企业与“一带一路沿线”和发展中国家进行高效的产品流通和输出、共享优势产能，共谋合作发展。

集合消费电子科技产品：汇聚海内外半导体产业中高新技术企业及各类高新技术产品集中展示，为各方创造项目合作、品牌建设、技术引导及投融资对接机会。

营造科技应用场景体验，引爆新传播潮流：突破传统展览闭环，导入市场新传播矩阵，沉浸式观展体验，同期热点营造话题引爆流量

观众来源

1.半导体产业集成电路设计、制造、封装测试、半导体材料、设备等中上下游企业高层领导及技术人员；

2.5G应用、大数据、物联网、3C笔电、消费电子、智能制造、智慧工厂、医疗、光通讯/光模块等终端应用企业高层领导及技术负责人；

3.政府相关部门、行业相关协会/学会、科研院所代表；

4.主流/专业媒体人及半导体投资机构。推荐品牌

展览时间

标准展位报到时间：2023年11月13--14日 特装布展时间：2023年11月10日—14日

展览开展时间：2023年11月15日—19日 展览撤展时间：2023年11月19日16：00

同期活动

2023广东省半导体产业发展趋势论坛

2023年珠三角芯片产业创新发展高峰论坛

2023中国IC设计与创新发展论坛

2023深圳嵌入式系统安全论坛

2023深圳集成电路封测行业技术交流会

2023深圳半导体设备与核心部件制造商交流会

2023深圳创新半导体器件与电源创新技术研讨会

2023芯片潮下粤港澳大湾区半导体产业发展的机遇与挑战

2023IC新产品新技术发布会

2023中国芯片设计成就奖颁奖典礼

2023激光图形转移技术在半导体封装中的应用

2023后摩尔定律时代下的先进封装分析

2023新兴先进半导体封装组装工艺的挑战

2023第三代半导体企业评奖

具体论坛演讲主题和议程以现场为准

展览范围

IC设计：IC及相关电子产品设计、IC产品与应用技术、IC测试方法与测试仪器、IC设计与设计工具、IC制造与封装、EDA、IP设计、嵌入式软件、数字电路设计、模拟与混合信号电路设计、集成电路布局设计、IDM、Fabless厂等；

晶圆制造及封装：晶圆制造、SiP先进封装、OSATs、EMS、OEMs、IDM、硅晶圆及IC封装基板、印制电路板、封装基板和设备及组装和测试等、封装设计、测试、设备与应用制造与封测、EDA、MCU、印制电路板、封装基板半导体材料与设备等；

集成电路制造：晶圆制造厂、晶圆代工厂、模拟集成电路、数字集成电路和数、模混合集成电路制造、集成电路终端产品等；

半导体设备制造：封装设备、扩散设备、焊接设备、清洗设备、测试设备、制冷设备、氧化设备、减薄机、划片机、贴片机、单晶炉、氧化炉、研磨机、热处理设备、光刻机、刻蚀机、抛光机、倒角机、离子注入设备、CVD/PVD设备、涂胶/显影机、前道测试设备、湿制程设备、热加工、涂布设备、单晶片沉积系统、固晶机、等离子清洗设备、切割机、装片机、键合机、焊线机、塑封机、回流焊、波峰焊、测试机、打弯设备、分选机、机器人自动化、机器视觉、其他材料和电子专用设备、耦合机、载带成型机、检测设备、恒温恒湿试验箱、传感器、封装模具、测试治具、精密滑台、步进电机、阀门、探针台、洁净室设备、水处理等；

封装与测试配套：测试探针台、探针卡、测试机、分选机、封装设备、封装基板、引线框架键合丝、引线键合、烧焊测试、自动化测试、激光切割及其它、研磨液、划片液、封片膜(胶)高温胶带、层压基板、贴片胶、上料板、焊线流量控制、石英石墨、碳化硅等；

第三代半导体：第三代半导体碳化硅SiC、氮化镓GaN、晶圆、衬底、封装、测试、光电子器件(发光二极管LED、激光器LD、探测器紫外)、电力电子器件(二极管、MOSFET、JFET、BJT、IGBT、GTO、ETO、SBD、HEMT等)、微波射频器件(HEMT、MMIC)等；

半导体材料：硅片及硅基材料、硅晶圆、硅晶片、单晶硅、硅片、锗硅材料、S01材料、太阳能电池用硅材料及化合物半导体材料、石英制品、石墨制品、防静电材料、光刻胶及其配套试剂、晶圆胶带、光掩膜版、电子气体、特种化学气体、CMP抛光材料、封装基板、引线框架、键合丝、包封材料、陶瓷基板、芯片粘合材料、光阻材料、湿电子化学品、溅射靶材、封测材料、切片、磨片、抛光片、薄膜等；

电子元器件：电阻、电容器、电位器、电子管、散热器、机电元件、连接器、半导体分立器件/IGBT、电声器件、激光器件、电子显示器件、光电器件、传感器、电源、开关、微特电机、电子变压器、继电器、印制电路板、集成电路、各类电路、压电、晶体、石英、陶瓷磁性材料、印刷电路用基材基板、电子功能工艺专用材料、电子胶(带)制品、电子化学材料及部品、无源器件、5G核心元器件特种电子、元器件、电源管理、储存器、连接器、线缆、接插器件、晶振、电阻、电位器磁性元件、滤波元件、PCB板、电机风扇、电声器件、显示器件、二极管、三极管滤波元件、开关及元器件材料及设备等；

综合：全国各地政府组团、半导体相关领域高科技产业园区、证券、银行、保险、基金、投资金融机构等。